

小型スパッタ装置

SS-DC・RF301



■ 概要

本装置は2” マグネトロンカソードと基板加熱機構をそれぞれ1基搭載した小型スパッタ装置です。JISラックサイズに全ての機能を詰め込み、省スペースと使いやすさを追求しています。

■ 特徴

1. 小型ながら本格的なスパッタ装置と同等の仕様・性能です。
2. 小型軽量シンプル設計により、事務機の約半分のスペースに設置可能です。
3. 基板上下機構により、ターゲットと基板間の距離を任意に設定出来ます。
4. 基板加熱を高温で行えます。
5. チラー標準装備により、電気とガスのみで運転が可能です。
6. フランジに互換性を持たせ、スパッタアップとスパッタダウンの組み替えが可能です。
7. スパッタ用電源はDC、RFのどちらも選択可能です。

■ 仕様 (SS-DC・RF301)

項目	内容
到達真空度	3×10 ⁻⁴ Pa以下
リーク量	1×10 ⁻⁸ Pa・m ³ /sec 以下 (Oリング透過分を除く)
排気系	TMP + ダイアフラムポンプ (またはロータリーポンプ)
真空計	フルレンジ真空計 (コールドカソード + ピラニーゲージ) + キャパシタンスゲージ (オプション)
基板ステージ	2インチ対応ステージ
基板加熱温度	MAX 500℃ (オプションでMAX800℃にも対応可能)
基板上下回転機構	ストローク100mm 手動操作 Oリング軸シール 回転速度 0~20rpm 可変 (回転機構はオプション)
カソード	マグネトロンカソード (詳細は下記)
ガス供給系	MFC1系統 (Ar) 1/4Swagelok (or 1/4VCR) 接続
本体架台	キャスター・アジャスター付き (電源部を含む)
サイズ・重量	W540・D600・H1280 (コネクター部分等を除く)、重量約100kg
用力	AC200V 単相 20A プロセスガス : Ar (1/4Swagelok 又は 1/4VCR) 窒素ガス (パージ用) : 0.05~0.1MPa (1/4Swagelok or 1/4VCR)

■ カソード仕様

項目	内容
ターゲットサイズ	2インチ
ターゲット材質	各種 メカニカルチャック方式 or ボンディング方式
冷却方法	水冷式 (チラーを搭載)
電源	DC出力300W または RF出力300W

※成膜につきましての仕様 (スパッタレート・分布等) は、仕様外となります。

超高温真空排気装置

排気セット

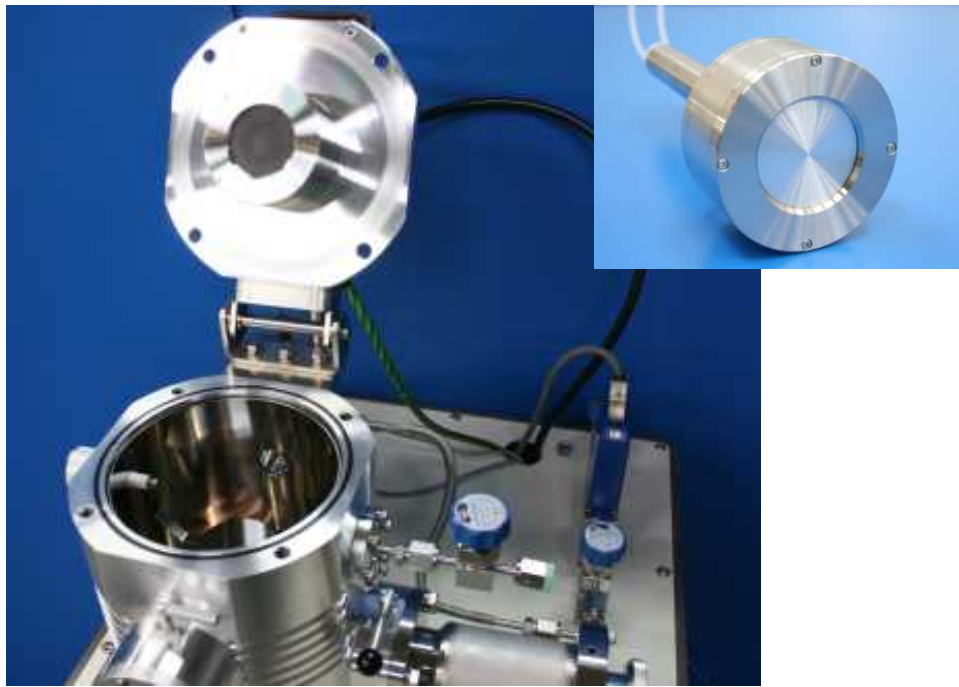
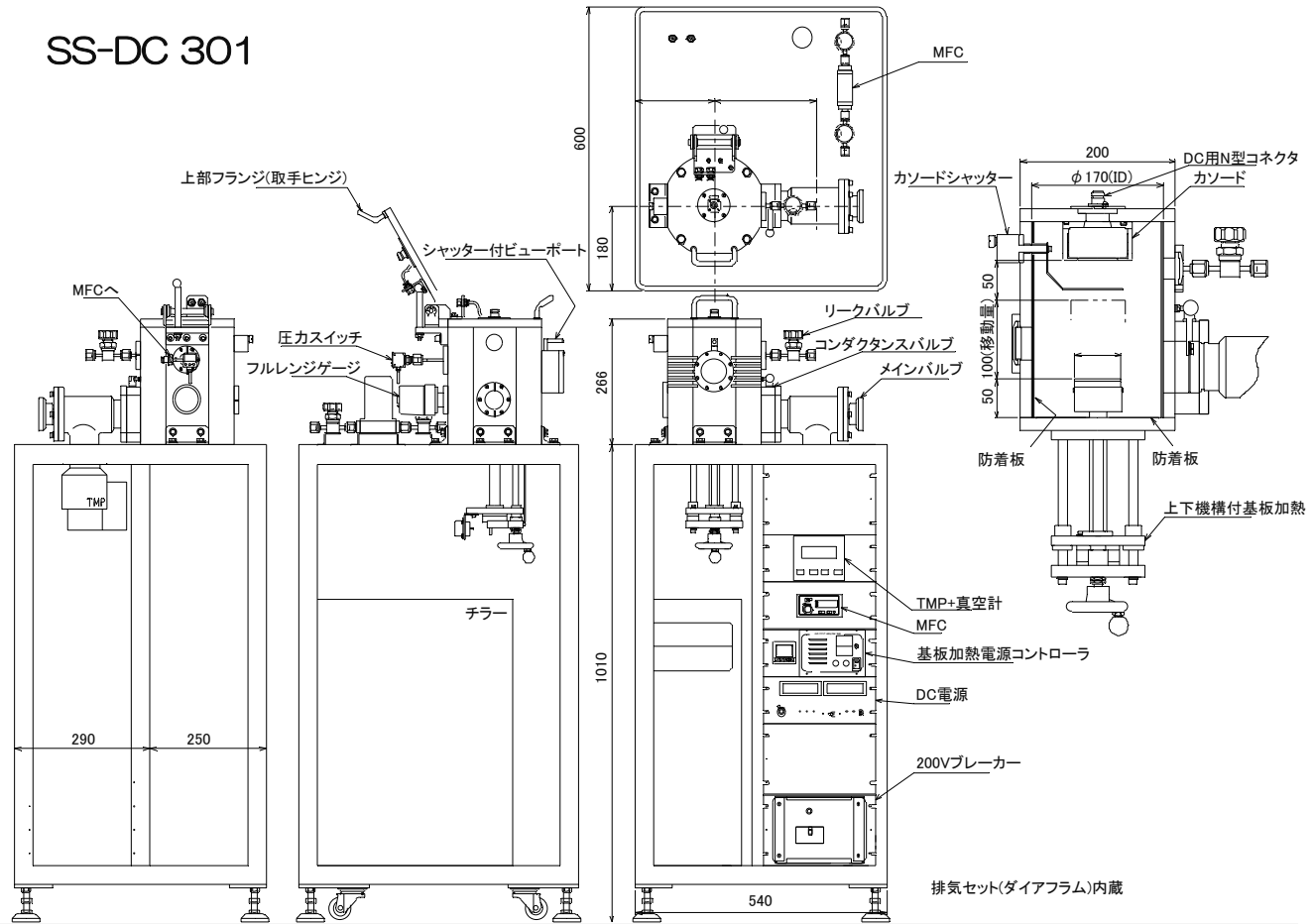
MBE装置

マイクロ波プラズマ
実験装置RFプラズマ
実験装置単結晶ダイヤモンド
合成用CVD装置ダイヤモンド合成用
HF-CVD装置

小型スパッタ装置

外観寸法図

SS-DC 301



* 改良のため予告なく仕様変更することがあります。

www.arios.jp

Vacuum & Plasma **ARIOS**

アリオス株式会社

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20
 TEL 042(546)4811 FAX 042(546)4814
 E-mail : info@arios.co.jp